

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第2区分  
 【発行日】平成24年1月19日(2012.1.19)

【公開番号】特開2010-140966(P2010-140966A)  
 【公開日】平成22年6月24日(2010.6.24)  
 【年通号数】公開・登録公報2010-025  
 【出願番号】特願2008-313533(P2008-313533)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/304 6 4 6  
 H 0 1 L 21/304 6 4 3 A  
 H 0 1 L 21/304 6 4 8 H  
 H 0 1 L 21/304 6 4 3 B  
 H 0 1 L 21/304 6 4 8 G

【手続補正書】

【提出日】平成23年11月28日(2011.11.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板に帯電した電荷を除去する帯電除去装置であって、  
 上記基板が供給される処理槽と、  
 上記基板の被処理面の電位レベルを検出する電位検出手段と、  
 この電位検出手段が検出する上記基板の被処理面の電位レベルに応じて所定の電子配置の気体を供給可能とする気体選択手段と

液体及び上記気体選択手段によって選択された気体が供給されこれら液体と気体とによって微細気泡を含む処理液を生成して上記基板の被処理面に供給する処理液供給手段とを具備したことを特徴とする基板の帯電除去装置。

【請求項2】

基板に帯電した電荷を除去する帯電除去装置であって、  
 上記基板が供給される処理槽と、  
 上記基板の被処理面の電位レベルに応じて所定の電子配置の気体を供給可能とする気体選択手段と

液体及び上記気体選択手段によって選択された気体が供給されこれら液体と気体とによって微細気泡を含む処理液を生成して上記基板の被処理面に供給する処理液供給手段とを具備したことを特徴とする基板の帯電除去装置。

【請求項3】

上記微細気泡はマイナスの電荷にプラスの電荷が静電結合されていることを特徴とする請求項1または2記載の基板の帯電除去装置。

【請求項4】

基板に帯電した電荷を除去する帯電除去方法であって、  
 処理槽に基板を供給する工程と、  
 上記基板の被処理面の電位レベルを検出する工程と、  
 検出された上記被処理面の電位レベルに応じて所定の電子配置の気体を選択する工程と

液体及び選択された上記気体によって微細気泡を含む処理液を生成して上記基板の被処理面に供給し上記微細気泡のもつ電荷によって上記被処理面に帯電した電荷を消失させる工程と  
を具備したことを特徴とする基板の帯電除去方法。